

Brucelles pour wafers en acier inoxydable 130 mm forme 3 DWF avec lame étagée et 3 dents - Bernstein 5-411

Réf. article BS-5-411

Fabricant Bernstein

EAN 4250838506441

Ces brucelles étroites pour wafers en acier inoxydable SA possèdent une lame inférieure étagée à 3 dents pour une prise sûre sur les bords. La forme 3 DWF convient aux wafers en verre, PCB et LCD sensibles. Avec 130 mm de longueur et 14 g, elles restent maniables et précises.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Longueur	13
Numéro de tarif douanier	82032000
Poids	0.014 kg



DESCRIPTION

La forme 3 DWF étroite des Bernstein 5-411 saisit les wafers sensibles avec assurance grâce à une lame inférieure étagée à 3 dents pour une meilleure prise.

AVANTAGES

- Lame inférieure étagée à 3 dents pour une prise sûre sur les bords étroits
- Forme 3 DWF adaptée aux wafers, PCB et LCD
- Acier inoxydable SA à surface mate polie et sans reflets
- Acier chrome-nickel austénitique offrant une bonne résistance à la corrosion
- Seulement 14 g pour 130 mm de longueur, pour un travail stable et précis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Lame	lame inférieure étagée, 3 dents, étroite
Forme	forme 3 DWF
Matériau	acier inoxydable SA
Surface	mate polie, lisse et sans reflets
Longueur totale	130 mm
Poids	14 g

UTILISATION

Elles conviennent au positionnement et à la préhension de composants plats et fins tels que des wafers fragiles (wafers en verre) ou des PCB et LCD extrêmement sensibles.

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- EAN 4250838506441
- Code douanier 82032000
- Pays d'origine Italie